

Kensflow 2360导热相变材料

Thermally Phase Change Interface Materials

◆ 概述

Kensflow 2360导热相变材料是由纳米级高导热填料与相变化合物配合而成并涂布于2mil厚铝箔两面的新型材料，专业用于功率消耗型器件与散热器的传热界面。

Kensflow 2360在52℃时发生相变，由固态变成粘糊状液态。从而保证功率消耗型器件与散热器的表面充分湿润，产生最低的热阻而形成优良的导热通道，使其散热器达到最佳的散热性能，从而改善了CPU、图形加速器，DC/DC电源模块，等功率器件的可靠性。Kensflow 2360导热相变材料具有象导热片一样可预先成型适合于器件安装，又具有象硅脂一样的低热阻特性，其结合了二者的完美特性。

◆ 特性

Kensflow 2360为有基材产品。方便粘贴操作和模切。

Kensflow 2360是不导电的，但是由于材料在通常的散热片安装中经受了相变，有可能金属与金属接触，因此Kensflow 2360不能作为电气绝缘来使用。

◆ 技术参数

项目	数值	单位	测试方法
外观	灰色		目测
总厚度	0.2	mm	ASTM D374
热阻抗	0.03	°C-in ² /w(50psi)	ASTM D5470
导热系数	3.0	w/m·k	ASTM D5470
相变温度	52	°C	ASTM D3418
密度	2.3	g/cm ³	ASTM D792
绝缘强度	不绝缘	Vac	ASTM D257
储运温度	<30	°C	—
适用温度范围	-55~125	°C	—
推荐散热器/器件夹紧压力	5-100 (0.035-0.7)	Psi(MPa)	—
贮存期	12	月	—

Kensflow 2360相变材料片在室温下有粘性，但不是结构粘合剂，不能用于直接粘接散热片到器件上，必须用夹子或其他的机械紧固件来维持散热片到器件的夹紧压。

Kensflow 2360 52℃相变温度，工作温度下的触变(糊状粘度)性能保证在垂直方向使用时材料都不会延伸或下滴且不导电。

Kensflow 2360能达到0.03 °C-in²/w低热阻性能。

◆ 应用

Kensflow 2360 应用于不需电气绝缘的场合,典型应用于CPU散热器,图形加速器的散热器等其它任何簧片固定的应用场合

如:

DC/DC电源模块	IGBT模块	功率模块
桥式整流器	存储器模块	微处理器
固态继电器		

Kensflow 2360导热相变材料

Thermally Phase Change Interface Materials

◆ 包装

Kensflow 2360导热相变材料的标准卷装尺寸为：

305mmX16.5m

305mmX50m

305mmX100m

Kensflow 2360导热相变材料也可根据客户的要求模切成几何尺寸产品，附在离型膜上供货。

具体事项请与kenseer销售部联系。

◆ 保存

Kensflow 2360导热相变材料应放在温度26℃以下，相对湿度为60%的环境下存放。贮存期限12个月。

◆ 订货代号

产品型号	订货代号	包装规格
2360	236016	305mmX16.5M
2360	236050	305mmX50M
2360	236010	305mmX100M

Kensflow 2360 导热相变材料

Thermally Phase Change Interface Materials

◆ 重要提示

这里所有叙述，技术信息和推荐均基于我们认为可靠实验。此文代替所有保证，明示或暗示的包括可卖性和用途的适用性。销售商,制造商仅负责更换被证明有缺陷的产品。使用以前,用户需决定用于其用途的产品的适用性。用户承担这里涉及的各种风险和责任。销售商和制造商不承担使用本公司产品所造成任何损失或损坏的法律责任,包括直接的,附带的或由此产生的利润或产值损失。

◆ 补救措施和责任限制

在kenseer 产品被证实有瑕疵的情况下,kenseer提供的补救方式为包退,包修或包换;kenseer对于无视法律声明而造成的损失或损害不承担责任,包括疏忽,担保或严格责任。



北京肯瑟高分子技术有限公司

电话:(8610)-51292882

传真:(8610)-51292842

电子信箱:info@kenseer.com

www.kenseer.com

Printed in China

© Copyright 2010 Kenseer Polymer Technology Co.,Ltd.